



Deutsche IMAPS Konferenz

14./15. Oktober 2008, München

Call for Papers

Die *Deutsche IMAPS-Konferenz 2008* findet erstmals an der *Hochschule München* in der Nähe des Hauptbahnhofes statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu einem der folgenden Themen der *Mikroelektronik*, des *Packaging* bzw. der *Aufbau- und Verbindungstechnik* einen Vortrag von ca. 20 Minuten Dauer halten:

Anwendungsfelder

Telekommunikation
Medizintechnik
Automobilelektronik
Luft- und Raumfahrt
Industrieelektronik
Logistik
Sensorik

Entwurf

Designsoftware
fertigungsgerechtes, testgerechtes Design
Simulation
thermische, thermomechanische,
Hochfrequenz-, Mikrowellensimulation

Systemaspekte/Problemlösungen

Zuverlässigkeit & Lebensdauer
Packaging
Halbleiter, MEMS, System in Package, Chip
Scale Packages, MCM, System on Chip
Fluidiksysteme
Optoelektronik
Mechatronische Systeme
Hochtemperaturelektronik
Leistungselektronik
Hochfrequenzelektronik
Prüfsysteme

Prozesse und Materialien

Wafer Level Prozesse
Keramische und organische Verdrahtungsträger
Materialien, 3D-Formung, HDI-Prozesse,
Inkjetdruck, Siebdruck, Fotolithografie,
Laserstrukturierung ...
Materialien
(Kleber, Lote und Vergussmassen,
Nanomaterialien, funktionelle Schichten)
Montage- und Verbindungstechnologien
FlipChip, Drahtbonden, SMT,
andere Verfahren
Prozessüberwachung

Bitte senden Sie Ihren Abstract (ca. 200 Wörter) bis zum **1. Juni 2008** an:

Dr.-Ing. Gisela Dittmar, Ingenieurbüro Elektroniktechnologie Dittmar, Egerlandstr. 88, D-73431 Aalen,
Tel. 07361/931129, Fax 07361/943004, gisela.dittmar@imaps.de

Es wird wieder ein BEST PAPER AWARD vergeben !

☞ *Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit der Online-Anmeldung unter: <http://www.imaps.de/>* ☞

Firmenporträt

KARO Electronics Vertriebs GmbH

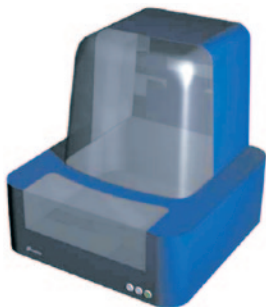
Seit einigen Monaten veröffentlichen wir an dieser Stelle in loser Folge Firmenporträts unserer Firmenmitglieder. In dieser Ausgabe: *KARO Electronics*

Die *KARO Electronics Vertriebs GmbH* liefert seit rund 20 Jahren:

- Test- und Analysegeräte für die Mikroelektronik (Ultraschall, Infrarot, UV, optisch)



Ultraschall Mikroskop Sonoscan Gen5
(Schnellstes und genauestes Gerät auf dem Markt)



IR-Inspektionsgerät InSense ISX8
(Inspektion von Waferbonds, Alignment von Wafer zueinander, Subsurface-Defekten, etc.)

- Produktionsmaschinen, Laboranlagen sowie komplette Linien für die Multilayer-Keramik (z.B. LTCC; HTCC, PZT, SOFC, MCFC, MLC usw.) Schwerpunkt sind



Foliengießanlagen, Stanzen, isostatische Laminierpressen, Stapelgeräte mit automatischer Ausrichtung.

Neben Verbrauchsmaterialien für die Multilayerkeramik liefert *KARO Electronics* in erster Linie Anlagen der folgenden Hersteller: *Aurel, InSense Technology, KMS-Kemmer, Kurabo Mazerustar, Nikkiso, Pacific Trinetics Corp. (PTC), Micro-tec, Sonoscan, UHT, Westech.*

KARO Electronics baut seit kurzem eigene Foliengießanlagen in Deutschland. Neben klassischen Anlagen mit Wärme-/IR-Trocknung werden innovative Anlagen mit UV-Vernetzung entwickelt und gebaut. Bedingt durch die extrem kurzen Vernetzungszeiten mit entsprechend kleineren Anlagen sind die Preise entsprechend niedriger. Daneben liegen auch die Betriebskosten deutlich unter denen von konventionellen Systemen. Von der technischen Seite ist der Aspekt interessant, dass es während der Vernetzung keinerlei Volumen- bzw. Dickenänderung der Folie und dadurch auch keine Rissbildung gibt. Außerdem sind diese Anlagen wesentlich umweltfreundlicher als klassische, bei denen lösemittelhaltige Schlicker (breiige Porzellanmassen) verarbeitet werden.

KARO Electronics Vertriebs GmbH, Algasinger Weg 14, 84405 Dorfen, Tel. 08081/9574-50, Fax -69, info@karoelectronics.de, www.karoelectronics.de

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
London, Old Windsor	11./12.6.2008	Micro Tech 2008	IMAPS UK
Paris	24./25.6.2008	INTERCONNEX	IMAPS France
Greenwich	1./4.9.2008	ESTC 2008	IEEE/CPMT
München	14./15.10.2008	IMAPS-Konferenz	IMAPS D

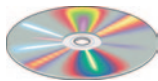
ESTC 2008

Wie bereits berichtet findet die *ESTC 2008* vom 1. bis zum 4. September in Greenwich, Großbritannien, statt. Bei Redaktionsschluss war das Tagungsprogramm leider noch nicht bekannt. Es wird im Internet unter der Adresse

www.estc.biz/technical_programme
veröffentlicht werden.

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *IMAPS-Herbsttagung 2007*, die am 8./9. Oktober 2007 in München stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papiausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, und der *Deutschen IMAPS-Seminare 2006* und *2007* zu den Themen *Muss jeder Sensor smart sein?* (Februar 2006 in Göppingen) und *Flip Chip – die Alternative zum Drahtbonden?* (Februar 2007 in Ilmenau) sind noch erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG Umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die neu gestalteten Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

Applikationszentrum Ilmenau

Gustav-Kirchhoff-Str. 5

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Albrecht-Erhard-Str. 17

D-73433 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

Schatzmeister

c/o Hesse & Knipps GmbH

Vattmannstraße 6

D-33100 Paderborn

Fon: 05251/1560-14

Fax: 05251/1560-97

e-mail: hans-ulrich.knipps@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer

Schriftführer

c/o FH Schmalkalden

FB Elektrotechnik

D-98574 Schmalkalden

Fon: 03683/688-5116

Fax: 03683/688-5499

e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dr. Martin Schneider-Ramelow

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit

und Mikrointegration

Chip Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25

D-13355 Berlin

Fon: 030/46403-172

Fax: 030/46403-271

e-mail: martin.schneider-ramelow@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VIA electronic GmbH

Robert-Friese Straße 3

D-07629 Hermsdorf

Fon: 036601/81-529

Fax: 036601/81-530

e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Lutz-Günther John
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-158
Fax: 030/310078-256
e-mail: lutz-guenther.john@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik
Pf 100565

D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing

D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de

[Potentielle Buch-Autoren]

für die Bereiche
Leiterplattentechnik · Baugruppenteknik
Mikrosystemtechnik · Nanotechnologie
Photovoltaik

Wenn Sie gerade dabei sind, ein Manuskript zu schreiben oder sich mit dem Gedanken tragen, ein solches in der Zukunft zu erstellen, entweder als alleiniger Autor oder als Co-Autor; wenn Sie alternativ daran interessiert sind, ein Buch herauszubringen oder sich an einem Buch als Autor beteiligen möchten, so würde der Leuze Verlag gerne darüber mit Ihnen sprechen.

Wenden
Sie sich bitte an
Sylvia Leuze-Reichert
sylvia.leuze-reichert@leuze-verlag.de

EUGEN G.
LEUZE
VERLAG

Karlstraße 4
D-88348 Bad Saulgau
Tel. 07581/4801-0
Fax 07581/4801-10

109 JAHRE 1902 – 2011